



PMC 精密機械研究發展中心

2026年8月

懶人包

臺灣機械產業發展現況與 全球競爭市場前瞻

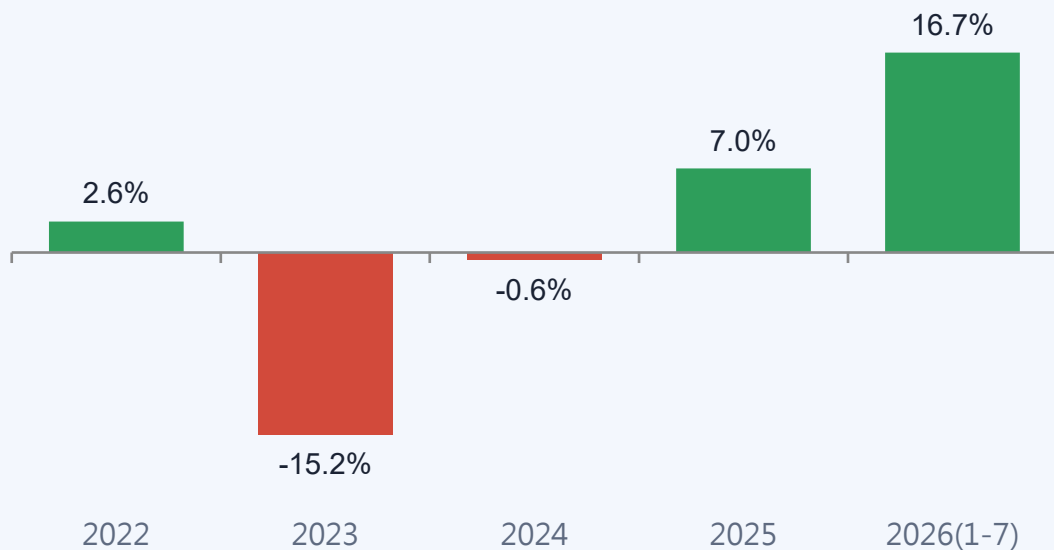
機械設備 · 半導體設備 · 工具機 · 橡塑膠機 · 木工機械 · 食品包裝與加工機



一、產業總覽

機械產業出口強勁反彈，成長曲線自 2024 年起向上

臺灣機械產業近年出口年增率（%）



2026年1-7月 機械產品出口總額

167.85 億美元

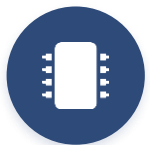
▲ 16.69%

主要出口市場

美國	25.98%
中國大陸	20.66%
新加坡	8.08%
日本	8.02%

成長領頭產品

半導體設備	▲ 44.51%
工業用機器人	▲ 24.82%
機械零組件	▲ 9.03%
工具機	▼ -1.47%



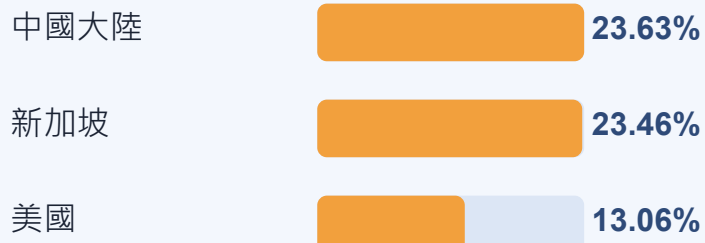
二、半導體設備業

2026年1-7月臺灣半導體設備出口，挾高性價比強勢回升

2026年1-7月 臺灣半導體設備出口

42.04 億美元 ▲ 44.51%

2026年1-7月 前三大出口市場



2025 全球出口排名

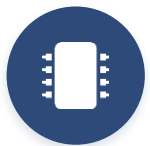
1	日本	20.15%
2	荷蘭	19.39%
3	新加坡	18.25%
4	美國	12.76%
5	韓國	6.11%
9	臺灣	3.61%

全球格局

- 日本2018-2025連年居冠；荷蘭2023升至第二，主攻光刻機（ASML）
- 新加坡2023升至第三，為臺灣主要競爭者
- 臺灣2025下滑至第九，2026年1-7月成長44.51%，排名可望回升

臺灣動能

- 前三大市場：中國23.63%、新加坡23.46%(+142.74%)、美國13.06%
- 國內晶圓代工龍頭帶動供應鏈赴海外擴產，業者加速China+1與在地化
- 臺灣以高性價比優勢搶占訂單，帶動出口成長



二、半導體設備業

機會：AI 擴建狂潮 挑戰：關鍵設備自主化



發展機會

- 2024年以來AI帶動高效能運算需求強勁，全球半導體廠擴建加速。
- 國內晶圓代工龍頭擴大美國投資，並布局日、德。
- SEMI預估2028年全球新增107座晶圓廠，其中91座建置中。
- 製程、封測設備、潔淨室、材料與零組件需求同步成長。



未來挑戰

- 本土高階設備全球市佔率僅約5%–10%，特定前段製程僅約4%。
- 微影、蝕刻、氣相沉積等關鍵設備由美、荷、日廠商掌握。
- 晶圓代工大廠估2030年在地採購零配件比達60%，惟未提系統設備比例。
- 高階設備自主化，將考驗我國半導體產業能否持續領先。

產業結構

約 490 家

半導體設備製造業，以中部以北為主，向台南、高雄擴展

國內業者概況

以廠務工程、封測設備、材料與零組件供應為主，具客製化、快速服務與供應鏈整合優勢。

國際大廠

應用材料·ASML·東京威力科創(TEL)·Lam Research·KLA



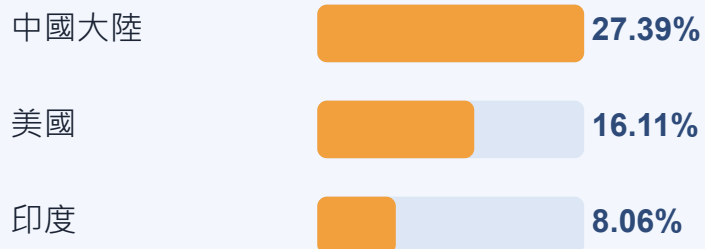
三、工具機

受惠半導體與 AI 伺服器，出口築底回升

2026年1-7月 臺灣工具機出口 (較前數月大有改進)

11.56 億美元 ▼ 1.47%

2026年1-7月 前三大出口市場



2025 全球出口排名

1	中國	20.76%
2	德國	16.50%
3	日本	13.75%
4	義大利	8.27%
5	美國	4.81%
7	臺灣	4.29%

全球格局

- 德國雄霸多年，2024年出口被中國超越
- 中國成本低、供應鏈完整、內需市場大，2024年躍居第一
- 臺灣曾為全球第四，2024年降至第八，2025年回升至第七

回升動能

- 前三大市場：中國27.39%、美國16.11%、印度8.06%(+17.59%)
- 2026年1-7月僅衰退1.47%，下半年出口可望翻轉向上
- 半導體設備與AI伺服器大幅成長，帶動業者轉往供貨與代工

- 2026年7月上市櫃工具機零組件業者營收年增67.38%，1-7月累計年增40.93%，顯示軟體與關鍵零組件需求升溫。系統廠7月營收年增27.76%，但轉型速度分化；部分未上市業者亦加速切入半導體設備零組件與高精密雷射加工等新商機。



三、工具機

產業轉向半導體新賽道，7月營收大幅成長

3.4 萬人

從業人口

1,600+ 家

廠商家數

90%

聚集大台中

完整供應鏈聚落

約90%廠商聚集方圓60公里大台中；從鑄造、零組件到整機組裝，形成完整上下游聚落，多為具生產彈性、快速交貨的中小企業。

新商機切入領域

AI伺服器組件・半導體設備零組件・無人機・機器人組件

政府與 PMC 協同 | 經濟部「工具機暨零組件產業生態系AI賦能解決方案示範場域」由PMC建立、2025年中啟用，以數位雙生與AI為核心，提供設計、製造、品檢、人才培訓一站式服務。

2026年7月 上市櫃業者營收成長

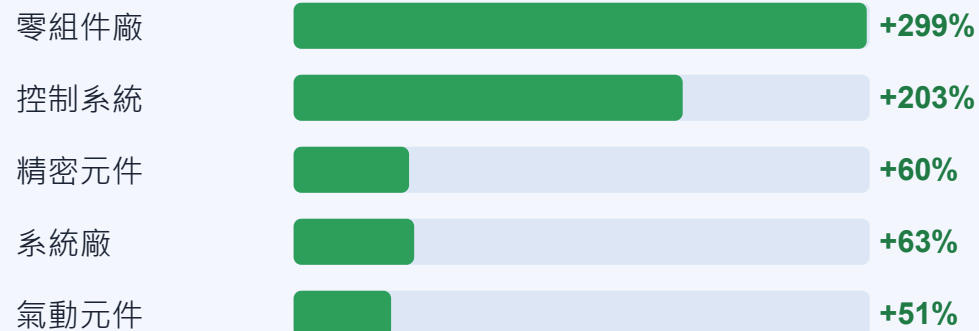
+67.38%

零組件廠 (10家)

+27.76%

系統廠 (14家)

7月營收成長觀察



零組件廠、系統廠大都進入半導體設備相關領域

臺灣適用10%且不疊加最惠國(MFN)稅率，優於日本、韓國的12.5%，對臺灣工具機及機械產業首度在關稅上取得競爭優勢。



四、橡塑膠機

受中國同級品價格競爭，出口承壓待轉型

2026年1-7月 臺灣橡塑膠機出口

3.96

億美元

▼ 16.34%

2026年1-7月 前三大出口市場

中國大陸

14.38%

越南

12.16%

印尼

11.15%

2025 全球出口排名

1	中國	29.17%
2	德國	20.21%
3	義大利	9.11%
4	日本	6.22%
5	美國	4.23%
8	臺灣	2.73%

產業特性

- 廠商約250-280家，約98%為中小企業，九成集中中南部
- 主力：塑膠射出成型機、押出機、中空成型機、吹膜機
- 2024年以來需求放緩與中國同級品競爭延續，產業亟需高值化轉型

挑戰與亮點

- 受中國同級產品價格競爭、全球需求放緩、匯率波動衝擊
- 分散市場、尋找新興國家銷售機會刻不容緩
- 部分業者投入高階電子零組件封裝設備，瞄準AI伺服器、GPU、電源模組



五、木工機械

守住全球前五，但出口自 2022 年後逐年下滑

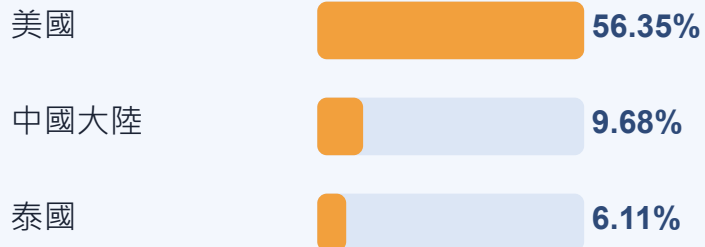
2026年1-7月 臺灣木工機械出口

2.36

億美元

▼ 16.11%

2026年1-7月 前三大出口市場



2025 全球出口排名

1	中國	27.29%
2	德國	22.77%
3	義大利	13.69%
4	奧地利	5.49%
5	臺灣	5.11%

產業特性

- 會員廠商約222家，中部188家(84.68%)，聚集豐原一帶
- 完整上下游供應鏈、高彈性與客製化接單模式
- 2025年維持全球第五大，惟較2021年出口金額已減半

挑戰與轉型

- 德、義主導高階市場；中國以價格優勢傾銷中低階
- 受全球房地產放緩、美國需求疲軟、匯率波動衝擊
- 轉型方向：MES導入、AI木皮分級、無人化搬運、自動避瑕疵與智慧排程



六、工業用機器人

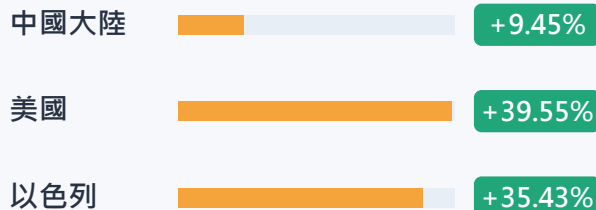
以成長率看出口動能：先切入生產、倉儲與接待，未來延伸服務應用

2026年1-7月 出口年增率

+24.82%

不以出口金額呈現，改以成長率觀察市場動能

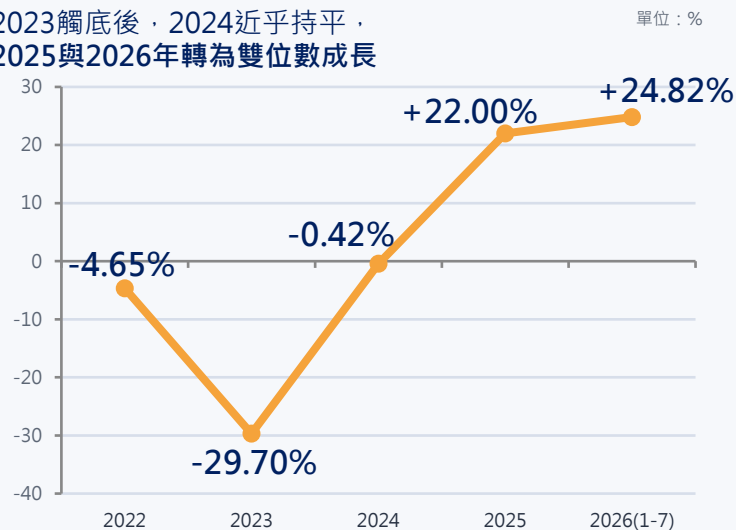
前三大市場同期成長率



美國與以色列成長率高，顯示海外自動化需求升溫。

我國近年出口成長率（%）

2023觸底後，2024近乎持平，
2025與2026年轉為雙位數成長



應用場域發展路徑

初期目標

工廠生產用機器人
倉庫管理用機器人
接待用機器人等

未來延伸

未來逐漸進入服務領域，包含照護用
機器人等。

先以工廠與倉儲等B2B場域驗證技術穩定性，再
擴大至服務型應用。

國內產業優勢：擅長發展機器人關鍵零組件與AI控制系統

攝影鏡頭

協助機器人辨識環境、定位物件
、接待導引與品質檢測。

減速機 / 關節零件

強化機器人關節精度、穩定度、
扭力控制與承載能力。

AI控制系統

整合感測、運動控制、路徑規劃
與自主決策能力。

發展建議

以零組件優勢切入，逐步延
伸至模組、整機與場域方案



七、食品包裝與加工機

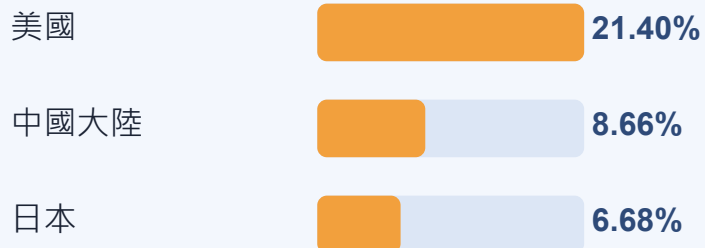
小而靈活、七成外銷，朝智慧化與低碳永續轉型

2026年1-7月 臺灣食品包裝與加工機出口

2.51 億美元

▼ 7.71%

2026年1-7月 前三大出口市場



2025 全球出口排名

1	德國	19.54%
2	義大利	16.69%
3	中國	12.51%
4	荷蘭	7.96%
5	美國	4.65%
—	臺灣	0.62%

產業特性

- 製造廠商逾400家，一年出口約5億美元，逾7成外銷
- 彈性製造、高性價比，具完整在地供應鏈
- 2024年以來受高利率與防禦性採購影響，業者轉向智慧化、低碳化與整線輸出

挑戰與展望

- 日圓低點引發轉單、高利率壓抑資本支出、防禦性採購
- 歐盟PPWR等減塑法規上路，包裝廠暫緩購機
- 展望：智慧化產線、低碳綠色包材、從單機銷售轉整廠自動化輸出

八、展會參與模式轉變



景氣牽動參展策略：由「固定參展」轉向「效益導向」



1

效益導向評估

機械設備屬資本財，受景氣、地緣政治與終端投資趨緩影響，企業更重視投資效益（ROI）。攤位、裝潢、機台運輸與差旅成本高，業者開始縮減規模、選擇性參展。



2

轉向自行集客

部分業者改於大型展會同期舉辦廠內展（Open House），利用國際買主聚集之機邀約接駁至廠內看機、試機。國際與臺灣部分大型業者均採類似模式，洽談精準度更高。



3

展會角色轉變

買主取得資訊管道多元，傳統「展示＋現場接單」功能弱化。EMO、IMTS 仍具全球交流價值，展會由「交易發生地」轉為「買主集聚與商機引流節點」。

結語

半導體設備與AI伺服器成為機械產業成長主引擎，帶動工具機、零組件業者轉入新賽道；橡塑膠機、木工機械、食品包裝機則面臨價格競爭與需求放緩，須靠智慧製造、低碳永續與高值化加速轉型。